

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 8 月 7 日(07.08.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/119675 A1

- (51) 国際特許分類:
G01R 31/302 (2006.01) *H01L 21/66* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/052145
- (22) 国際出願日: 2014 年 1 月 30 日(30.01.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-018683 2013 年 2 月 1 日(01.02.2013) JP
- (71) 出願人: 浜松ホトニクス株式会社(HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市東区市野町 1 1 2 6 番地の 1 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者: 中村 共則(NAKAMURA Tomonori); 〒4358558 静岡県浜松市東区市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).
西沢 充哲(NISHIZAWA Mitsunori); 〒4358558 静岡県浜松市東区市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9 階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

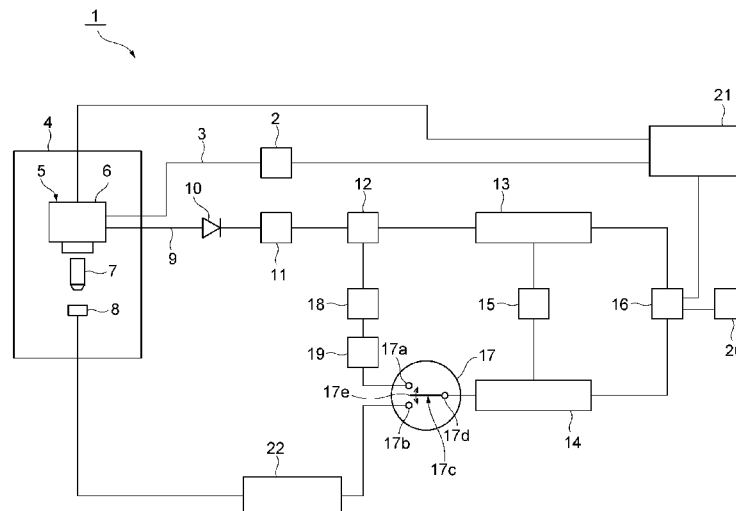
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE INSPECTION DEVICE AND SEMICONDUCTOR DEVICE INSPECTION METHOD

(54) 発明の名称: 半導体デバイス検査装置及び半導体デバイス検査方法



(57) Abstract: This semiconductor device inspection device is provided with a laser light source which generates a light irradiated onto the semiconductor device, an optical sensor which detects light reflected on the semiconductor device and outputs a detection signal, a tester unit for applying a drive signal to a semiconductor device, an electric measurement unit into which the detection signal is inputted, an electric measurement unit into which the detection signal and the drive signal are selectively inputted, and a switching unit having a detection signal terminal and a drive signal terminal. The switching unit inputs the detection signal to the electric measurement unit by connecting a connection unit to the detection signal terminal, and inputs the drive signal by connecting the connection unit to the drive signal terminal.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2014/119675 A1

半導体デバイス検査装置は、半導体デバイスに照射される光を発生するレーザ光源と、半導体デバイスで反射された反射光を検出し、検出信号を出力する光センサと、駆動信号を半導体デバイスに印加するテストユニットと、検出信号が入力される電気計測部と、検出信号及び駆動信号が選択的に入力される電気計測部と、検出信号端子及び駆動信号端子を有する切替部と、を備える。切替部は、接続部を検出信号端子に接続することで電気計測部に検出信号を入力させ、駆動信号端子に接続することで駆動信号を入力させる。